

F

E

D

C

B

A

F

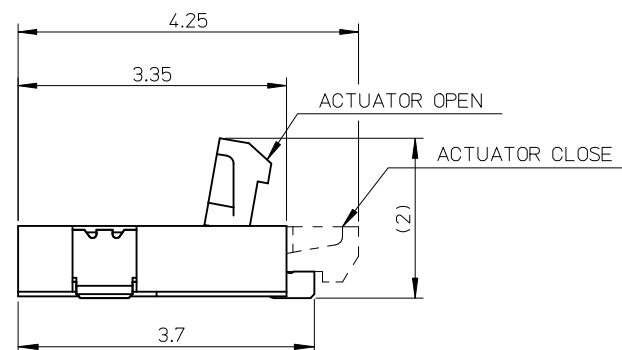
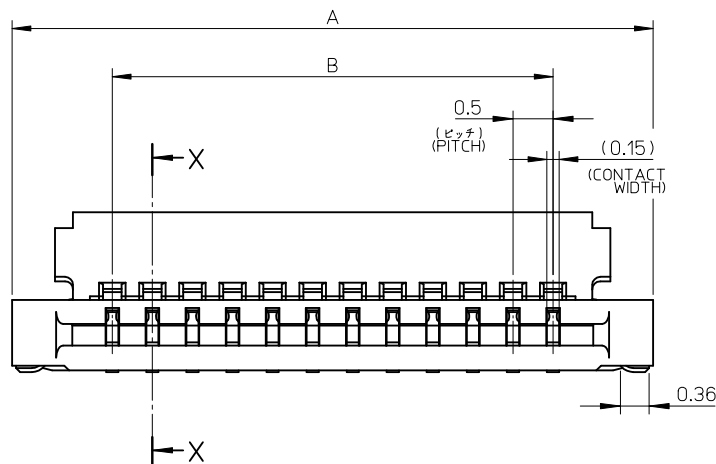
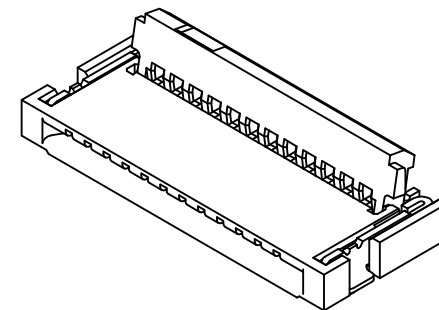
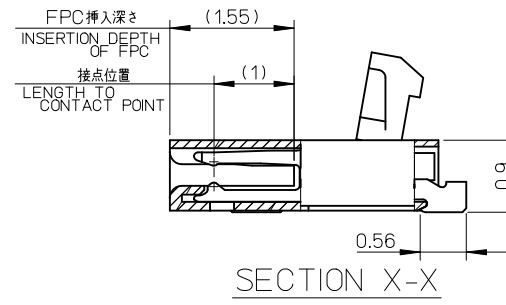
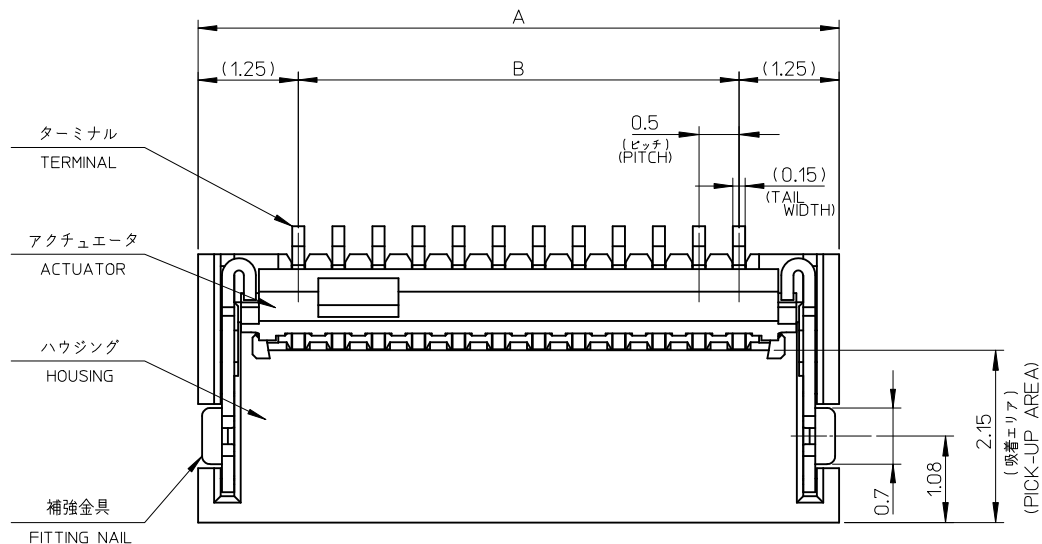
E

D

C

B

A

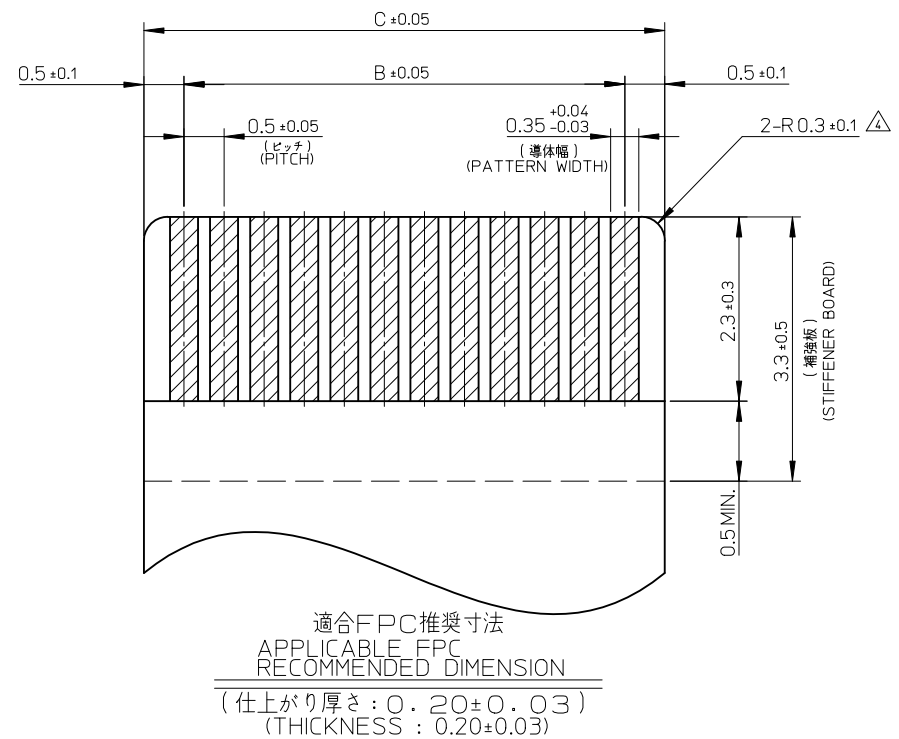
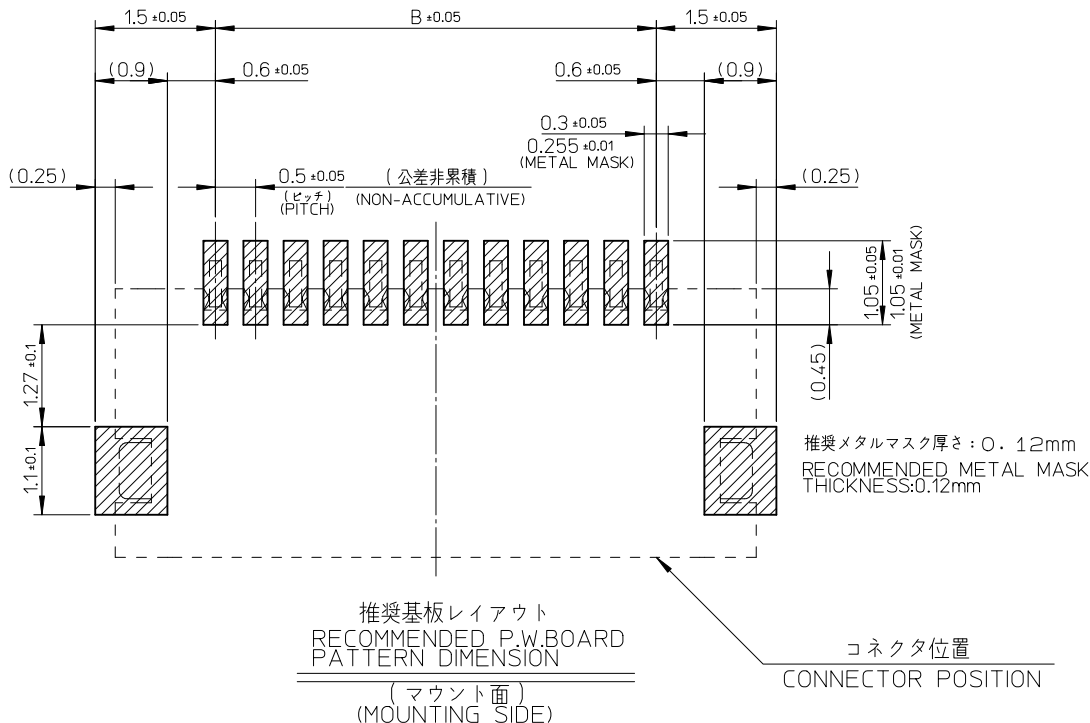


23	22	24.5	502118-4591	45
C	B	A	EMBOSSED PACKAGING	極数
			オーダー番号 ORDER NO.	CIRCUITS

CONNECTOR SERIES NO. : 502118-**-21

RELEASED EC NO: J2010-1059 DRWN:HON001 2009/11/19 CHKD:HSIMOYAMA 2009/11/19 APPR:KNORIKAWA 2009/11/19	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE —//—	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION		
		10 UNDER	± 0.2	DRAWN BY HONO	DATE 2008/11/19	TITLE 0.5 FPC CONN BACK FLIP H=0.9 UPR/BTM CONT				
		10 OVER 30 UNDER	± 0.25	CHECKED BY HSIMOYAMA	DATE 2008/11/19					
		30 OVER	± 0.3	APPROVED BY HHIRATA	DATE 2008/11/19	MOLEX INCORPORATED				
		ANGULAR	±1 °	MATERIAL NO.						
	DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE CHART		SD-502118-003				1 OF 2	
	REV	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION								

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1



注 記 NOTE

1. 使用材料 MATERIAL

- ハウジング : 液晶ポリマー, 色: 白
HOUSING GLASS FILLER, UL94V-0
LIQUID CRYSTAL POLYMER, COLOR: WHITE
GLASS FILLED, UL94V-0
- アクチュエータ : ポリアミド樹脂, 色: 黒
ACTUATOR GLASS FILLER, UL94V-0
POLYAMIDE, COLOR: BLACK
GLASS FILLED, UL94V-0
- ターミナル : りん青銅 (t=0.15)
TERMINAL PHOSPHOR BRONZE (t=0.15)
- 補強金具 : りん青銅 (t=0.15)
FITTING NAIL PHOSPHOR BRONZE (t=0.15)

3. 端子、補強金具の平坦度は0.1以下とする。
SOLDER TAILS AND FITTING NAILS
COPLANALITY TO BE 0.1 MAXIMUM.

- △ R0.3はFPC導体部にかからないこと。
R0.3 MUST NOT BE OVERLAPPED
TO PATTERN OF FPC.

5. ELV及びRoHS適合品
ELV AND RoHS COMPLIANT.

6. 基板実装前にアクチュエータを操作しないで下さい。
必ず基板に実装し、FPCを挿入してからアクチュエータを操作して下さい。
PLEASE DO NOT OPERATE THE ACTUATOR
BEFORE MOUNTING.
PLEASE OPERATE THE ACTUATOR AFTER MOUNTING ON
THE SUBSTRATE, AND MATING FPC.

FPCについて
ABOUT FPC

抜き方向は、導体側から補強板を推奨します。
補強板材質は、ポリイミドを推奨します。
接着剤は熱硬化接着剤を推奨します。
なお、接着剤の接点部への付着は導通不良の
原因となりますので染み出しの無いよう、お願いします。

RECOMMENDED PUNCHER DIRECTION :
FROM CONDUCTOR SIDE TO STIFFENER BORAD SIDE.

RECOMMENDED MATERIAL :
STIFFENER BOARD : POLYIMIDE
BONDING AGENT : THERMOSETTING AGENT
PLEASE PUT APPROPRIATE AMOUNT OF ADHESIVE ON ADHEREND
BECAUSE THERE IS A POSSIBILITY
THAT THE EXTRA ADHESIVE CAUSES THE DEFECT
IN ELECTRICAL CONTINUITY.

2. めっき仕様 PLATING

- ターミナル : コンタクト部: 金めっき (0.1 µm 以上)
TERMINAL テール部: 金めっき
下地: ニッケルめっき (1.0 µm 以上)
CONTACT AREA: GOLD PLATING (0.1 µm MINIMUM)
SOLDER TAIL AREA: GOLD PLATING
UNDER PLATE: NICKEL PLATING (1.0 µm MINIMUM)
- 補強金具 : 仕上: 錫めっき (1.0 µm 以上)
FITTING NAIL 下地: ニッケルめっき (1.0 µm 以上)
PALTE: TIN PLATING (1.0 µm MINIMUM)
UNDER PLATE: NICKEL PLATING (1.0 µm MINIMUM)

RELEASED EC NO: J2010-1059 2009/11/19 DRWN:HON001 CHKD:HSHIMOYAMA 2009/11/19 APPR:KNORI KAWA 2009/11/19 REV	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE —/—	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION		
		10 UNDER	± 0.2	DRAWN BY HONO		DATE 2008/11/19	TITLE 0.5 FPC CONN BACK FLIP H=0.9 UPR/BTM CONT			
		10 OVER 30 UNDER	± 0.25	CHECKED BY HSHIMOYAMA		DATE 2008/11/19				
		30 OVER	± 0.3	APPROVED BY HHRATA		DATE 2008/11/19	MOLEX INCORPORATED			
		ANGULAR ±1 °		MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.				
		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE CHART		SD-502118-003		2 OF 2		
				SIZE A3	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION					

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

F

E

D

C

B

A

F

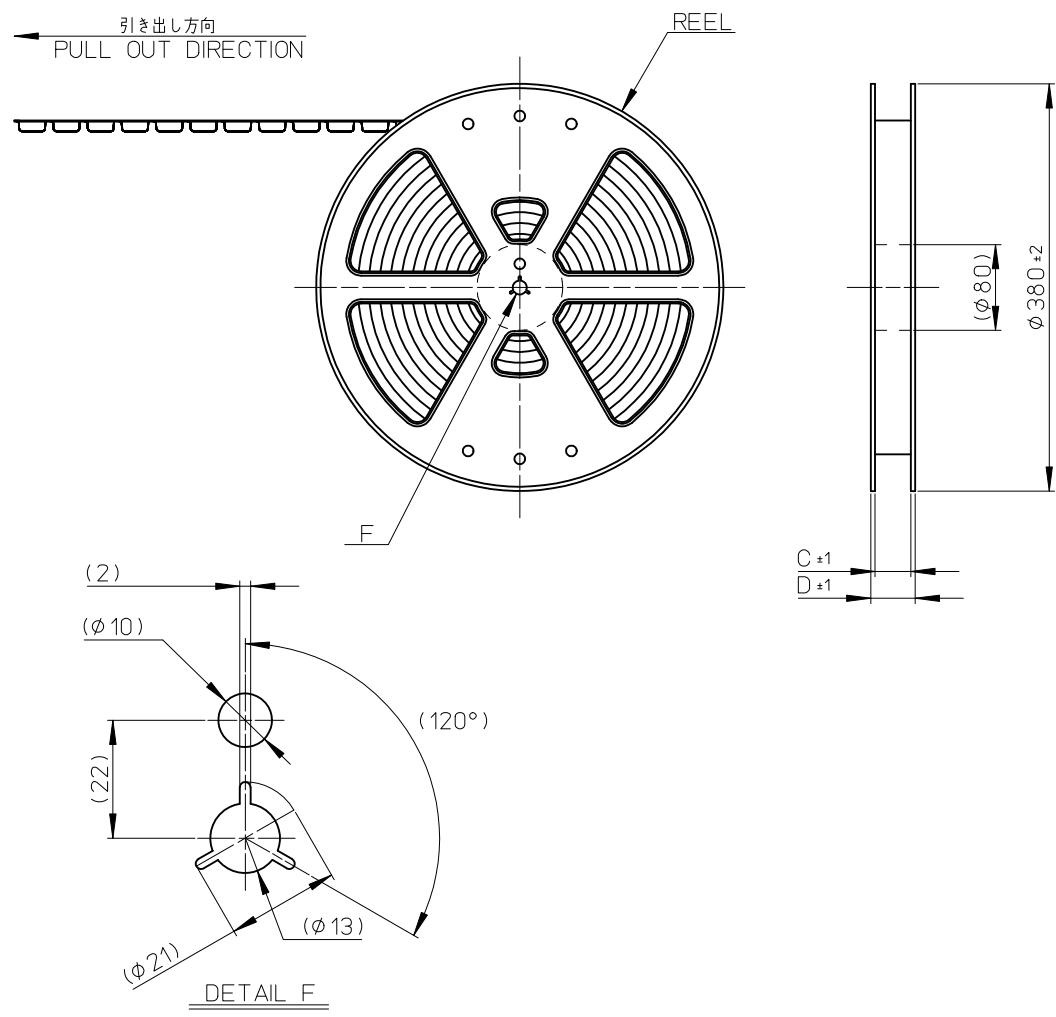
E

D

C

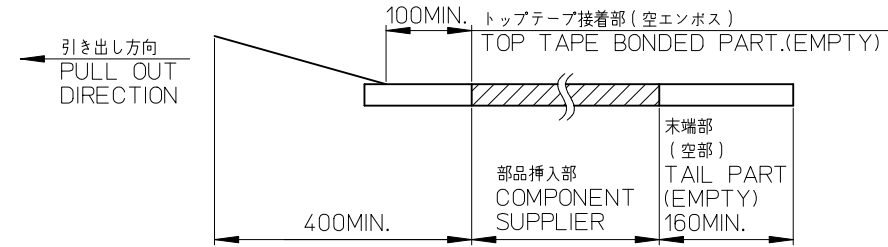
B

A



NOTES

- 1.製品詳細寸法については製品単体図面を参照下さい。
RE DETAILED DIMENSION, SEE PRODUCT DRAWING.
- 2.梱包数量: 2500個/リール
NUMBER OF CONNECTORS 2500PCS/REEL
- 3.リードテープ長さ
LEAD TAPE LENGTH



- 4.材料
MATERIAL
キャリアテープ(CARRIRE TAPE): ポリスチレン (POLYSTYRENE)
トップテープ(TOP TAPE): PET, PE, PEF
リール(REEL): ポリスチレン (PS) <リサイクル材を含む>
POLYSTYRENE(PS) <RECYCLE MATERIAL CONTAILED>
- 5.ELV及びRoHS適合品
ELV AND RoHS COMPLIANT.

RELEASED EC NO: J2010-1059 DRWN:HON001 CHKD:HSHIMOYAMA APPR:KNORIKAWA	DESCRIPTION REV	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION						
		10 UNDER	± ---	DRAWN BY HONO	DATE 2008/11/19	TITLE 0.5 FPC CONN BACK FLIP H=0.9 UPR/BTM CONT EMBSTP PKG								
		10 OVER 30 UNDER	± ---	CHECKED BY HSHIMOYAMA	DATE 2008/11/19									
		30 OVER	± ---	APPROVED BY HHIRATA	DATE 2008/11/19	MOLEX INCORPORATED								
		ANGULAR ±--- °		MATERIAL NO. SEE CHART							DOCUMENT NO. SD-502118-004		SHEET NO. 1 OF 2	
		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SIZE A3	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION									
	0													

10987654321

F

E

D

C

B

A

F

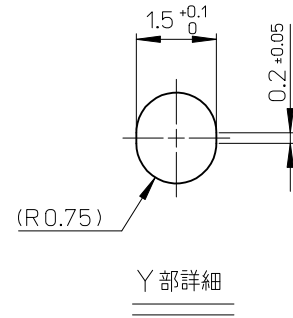
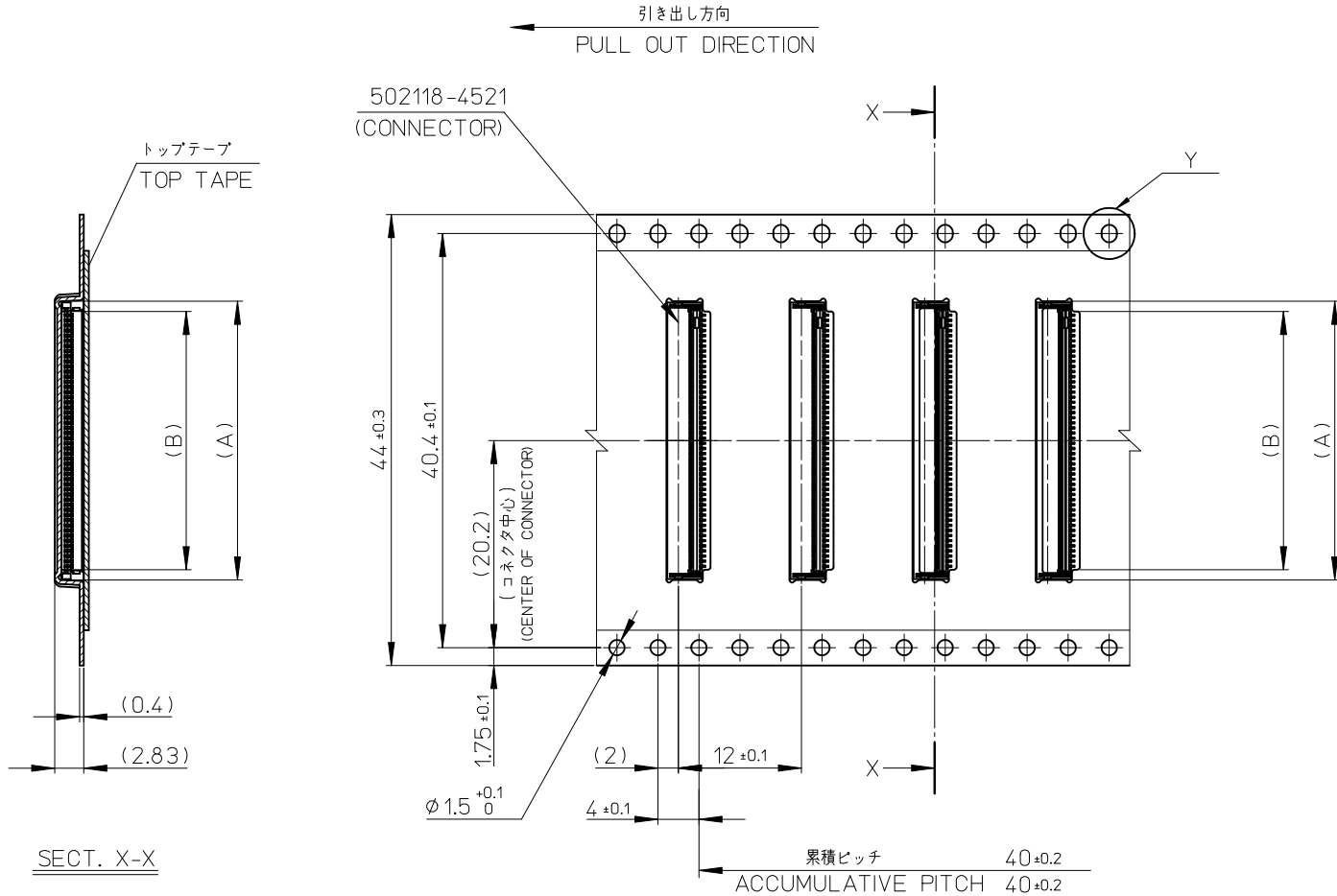
E

D

C

B

A



44	49.4	45.4	22.7	24.7	502118-4591	45
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	D	C	(B)	(A)	製品番号 MATERIAL NO.	極数 CIRCUITS

RELEASED EC NO: J2010-1059 DRWN:HON001 CHKD:HSHIMOYAMA APPR:KMORIKAWA O	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION	
		10 UNDER	± ---	DRAWN BY HONO	DATE 2008/11/19	TITLE 0.5 FPC CONN BACK FLIP H=0.9 UPR/BTM CONT EMBSTP PKG			
		10 OVER 30 UNDER	± ---	CHECKED BY HSHIMOYAMA	DATE 2008/11/19				
		30 OVER	± ---	APPROVED BY HHIRATA	DATE 2008/11/19	MOLEX INCORPORATED			
		ANGULAR ±--- °		MATERIAL NO. SEE CHART					DOCUMENT NO. SD-502118-004
	REV	DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SIZE A3	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION				



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.